



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL**

CONSULTA PÚBLICA Nº 20, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

O Secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de **alteração** do Processo Produtivo Básico – PPB de **TELEFONE CELULAR DO TIPO SMARTPHONE COM MÓDULO OU COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO.**

O texto também está disponível no sítio da Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, no endereço:

<http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/ppb/2230-consulta-ppb-2017>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes *e-mails*: cgel.ppb@mdic.gov.br, mcti.ppb@mct.gov.br e cgapi@sufama.gov.br.

IGOR NOGUEIRA CALVET
Secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial

ANEXO

PROPOSTA Nº 032/2017 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO DE TELEFONE CELULAR DO TIPO SMARTPHONE COM MÓDULO OU COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO:

1) O Processo Produtivo Básico estabelecidos pelas Portarias Interministeriais nº MDIC/MCTI nº 343 e 344, de 19 de novembro de 2015, passa a ser o seguinte:

(Minuta em forma de Portaria, versão da Lei de Informática, Portaria Interministerial nº 344/15)

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para o produto TELEFONE CELULAR DO TIPO SMARTPHONE COM MÓDULO OU COMPONENTE SEMICONDUTOR DEDICADO DE ALTA INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO produzido no País, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 344, de 19 de novembro de 2015, passa a ser o seguinte:

I – desenvolvimento do projeto do módulo semicondutor de alta integração (**SIP – Systems-in-Package**), atendendo aos critérios estabelecidos pela Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, e suas atualizações;

II - montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso do módulo semicondutor de alta integração (**SIP – Systems-in-Package**);

III - moldagem e blindagem em conformidade de contorno;

IV – execução dos sulcos a laser (**laser grooving**) e pulverização catódica (**sputtering**);

V - singularização de encapsulamentos;

VI - gravação teste de *software*;

VII - montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso principal do smartphone, incluindo a colocação de módulo semicondutor (SiP) de alta integração;

VIII - integração das placas de circuito impresso, subconjuntos e das partes elétricas e mecânicas na formatação do produto final; e

IX - calibração e teste final.

§ 1º Todas as etapas deverão ser realizadas no País.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2018, fica dispensada a etapa constante do inciso “I”.

§ 3º A obrigatoriedade das etapas constantes dos incisos de “II” a “VI” deve obedecer ao seguinte cronograma:

Até 31 de dezembro de 2020	2021	2022	De 1º de janeiro de 2023 em diante
Dispensado	60%	80%	90%

Art. 2º O módulo semicondutor de alta integração (**SIP – Systems-in-Package**) a que se refere o art. 1º é um dispositivo de alta integração e desempenho, deve possuir, dentre outras, as seguintes características:

I - incluir cumulativamente as funções de "*cellular base band modem*", "*cellular RF transceiver*", "*RF Front End*", processador, gestão de energia e memória;

II - envolver os necessários componentes ativos e passivos encapsulados de forma indivisível, formando um corpo único, como um circuito integrado montados em uma placa de circuito impresso de alta densidade ("PCBA");

III – ser individualmente anexável ao PCBA; e

IV - possuir blindagem dos compartimentos de RF (*eletromagnetic interference-EMI/ Eletromagnetic Compatibility-EMC*).

Art. 3º Cada smartphone com módulo ou componente semicondutor dedicado de alta integração e desempenho produzido de acordo com as regras estabelecidas nesta Portaria pode ser contabilizado, na mesma proporção que os aparelhos que incorporem o middleware Ginga, no cumprimento da obrigação de fabricação de telefones celulares com capacidade de recepção de sinais de TV Digital, conforme exigido pelo PPB de terminal portátil de telefonia celular.

Art. 4º Até 31 de maio de cada ano, as empresas beneficiárias deverão encaminhar à Secretaria de Política de Informática - SEPIN, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e à Secretária de Desenvolvimento e Competitividade Industrial - SDCI, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, relatório do ano anterior contendo informações referentes à produção dos itens com os benefícios fiscais respectivos e cumprimento dos percentuais previstos nesta Portaria.

Art. 5º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações.

Art. 6º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 344, de 19 de novembro de 2015.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.